

2026年10月28日

積水化成品工業株式会社（本社：大阪市北区西天満2-4-4 社長：古林育将）は、グループ会社である株式会社積水化成品滋賀の敷地内に、ポリマー微粒子「テクポリマー」の新たな製造プラントを建設することを決定しました。約30億円を投資し、2030年4月の稼働開始を予定しています。

高機能ポリマー微粒子 テクポリマー®の新プラント建設を決定

－ 高付加価値分野への展開を加速し、さらなる事業成長へ －

1. 新プラント建設の背景と目的

当社は、ポリマー微粒子「テクポリマー」の事業を、2030年度に向けた中長期経営戦略における事業ポートフォリオ変革を牽引する成長事業の一つに位置付けています。

「テクポリマー」は、独自の粒子設計技術を生かし、電子材料をはじめとする幅広い高付加価値分野への展開を進めています。その成長領域の一つとして、生成AIの普及やデータセンターの増設などを背景に、半導体・電子材料分野で「テクポリマー HSシリーズ」の採用が進捗しています。

今後も幅広い分野での需要拡大を見据え、テクポリマー事業のさらなる成長を図るため、新たな製造プラントを建設します。

2. 「テクポリマーHSシリーズ」の特長と用途

「テクポリマー」は、粒子の大きさや組成・構造を用途に合わせて設計し、さまざまな機能を付与できるポリマー微粒子であり、電子材料をはじめとする幅広い高付加価値分野への展開を進めています。

その一つである「テクポリマー HSシリーズ」は、中空構造による低誘電性に加え、軽量性、応力緩和性、加工耐性、設計の自由度を備えています。半導体封止材、銅張積層板、電子回路基板用インキなどに添加するフィラー材料として採用が進んでおり、その他の用途においても顧客評価が進行しています。

3. 新プラントの概要

- 建設地：株式会社積水化成品滋賀 敷地内（滋賀県甲賀市）
- 投資額：約30億円
- 稼働開始：2030年4月（予定）
- 供給用途：半導体封止材、銅張積層板、電子回路基板用インキ等
- 設備方針：さらなる需要拡大に応じて生産能力を強化できる構成



4. 今後の展開

「テクポリマー HSシリーズ」をはじめとする高付加価値製品の成長を通じて、ポリマー微粒子事業の規模拡大と当社グループの収益力向上を図り、2030年度目標のROE 8%以上・営業利益率8%以上の達成に貢献するとともに、持続的な企業価値の向上を目指します。

■ 本件に関するお問い合わせは

コーポレート戦略本部 コーポレートコミュニケーション部

E-mail: ir_pr@sekisui-kasei.com URL: <https://www.sekisui-kasei.com>

以上